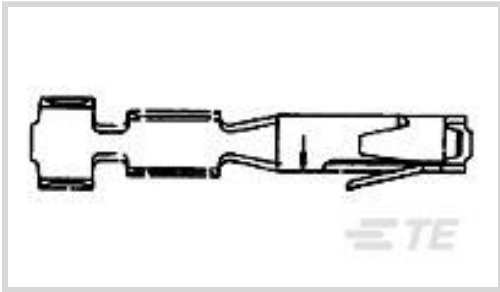




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器端子



端子类型: **插座**

连接器系统: **缆到缆**

端子接触部电镀材料: **金**

Wire Size: **.21 – .51 mm²**

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子方向	直式
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

尺寸



Accepts Wire Insulation Diameter Range	.91 – 1.37 mm[.035 – .054 in]
Wire Size	.21 – .51 mm²

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	200
封装方法	Loose Piece

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

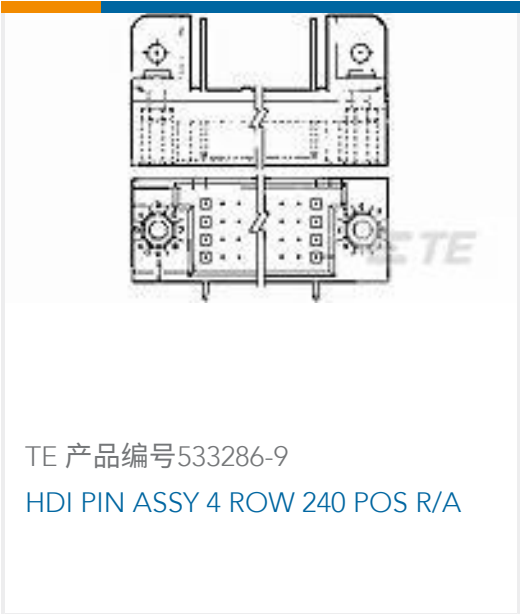
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

TANDEM SPR. REC.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_166722-2_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_166722-2_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_166722-2_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166722-2_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166722-2_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166722-2_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本